

お客様各位

2008年8月18日
富士電機デバイステクノロジー㈱
半導体開発営業本部

ゼットラップの廃型 及び 最終ご注文時期のご連絡

拝啓、貴社益々ご隆昌の段、大慶に存じます。
平素は弊社半導体製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて掲記の件、長らくご愛顧を賜りました弊社サージ保護素子「ゼットラップ」につきまして今般、事業及び機種の新規と生産中止を下記の通り実施致します。
尚、本件につきましては物量の減少と急激な部材・電力費高騰により今後の生産維持が困難となり誠に恐縮ではございますが廃型のご連絡と最終ご注文受付時期のご連絡となることをご了承賜りたくお願い申し上げます。
さらに今後とも弊社半導体製品の相変わりにませぬご愛顧と引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

- 1) ご案内内容：
 - ① サージ保護素子「ゼットラップ」の事業撤退・廃型・生産中止の実施
 - ② 最終ご注文受付時期のご連絡

- 2) 廃型生産中止対象型式：ゼットラップ全型式

- 3) 保守・廃型実施時期及び最終ご注文受付時期
 - ① 保守品移行 : 2007年10月～(実施ご連絡済)
 - ② 廃型化 : 2008年10月より廃型
 - ③ 最終ご注文受付 : 2009年3月末
 - ④ 最終出荷時期 : 2009年9月末まで

- 4) 別表
 - ① 保守・廃型対象型式一覧表
 - ② 他社類似品一覧表

なお、詳細は弊社営業窓口までお問合せ下さい。

以上